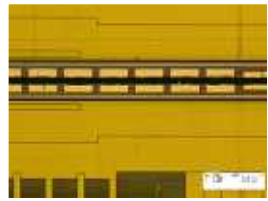
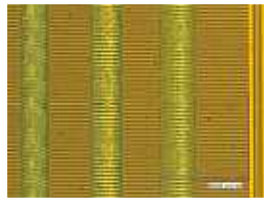


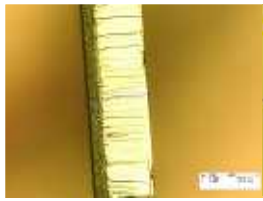
DRAM (< 25 μm幅フルカット)



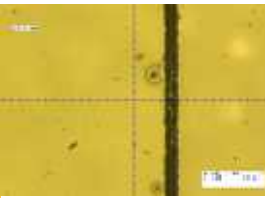
レジスト除去(線状)



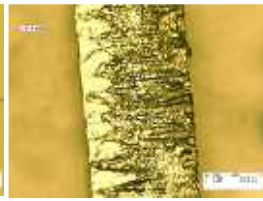
SiCチップスクライブ



サファイアスクライブ



300 μmGaAsスクライブ断面



浅いスクライブ切断(ガラス)



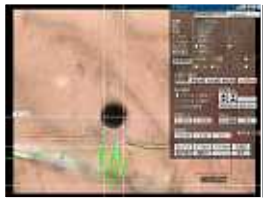
円形ガラスフルカット



カプトン断面、表面カット



ポリイミド 30 μm



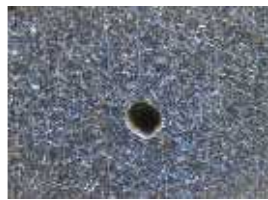
Si 50 μm



インバー 30 μm



ステンレスメッシュ 30 μm



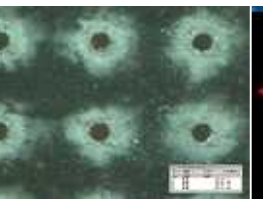
Sin 20 μm



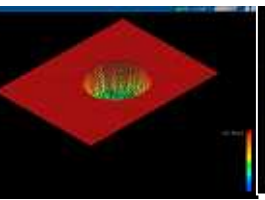
鉄 30 μm



ガラスエポキシ貫通構造



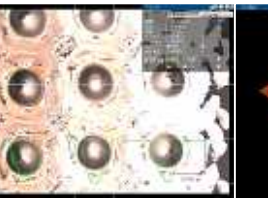
LiTaO3穴あけ



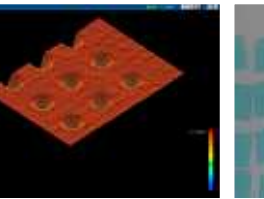
基板上ポリイミド膜穴あけ



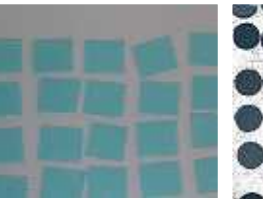
Si貫通孔メッシュ



カーボン上6 μmデント



色ガラスダイシング



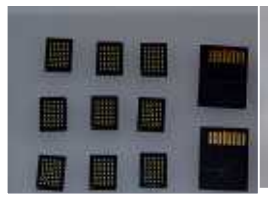
円形ガラス



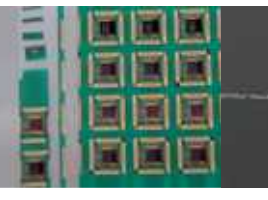
異形コーティングガラス



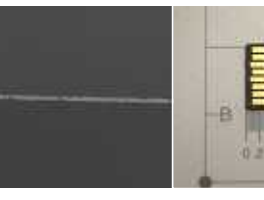
扇型コーティングガラス



電子部品個片化



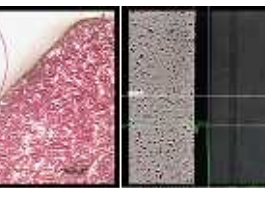
30 μm薄膜カットライン



異形フルカット(μSDカード)



Si + ガラス食違いカット



3 μm リムーブ



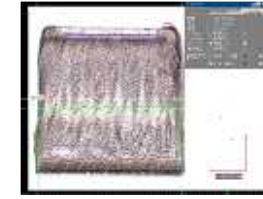
セラミックフルカット(TiBaO3)



超硬セラミックダイシング過程

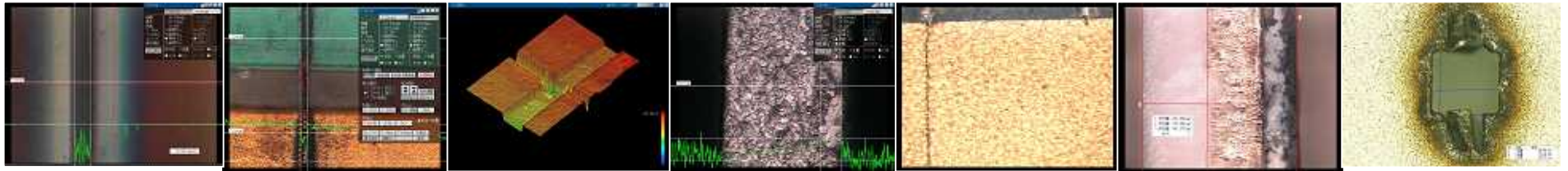


バイオチップ(10 μmスリット列)



マイクロ溶接





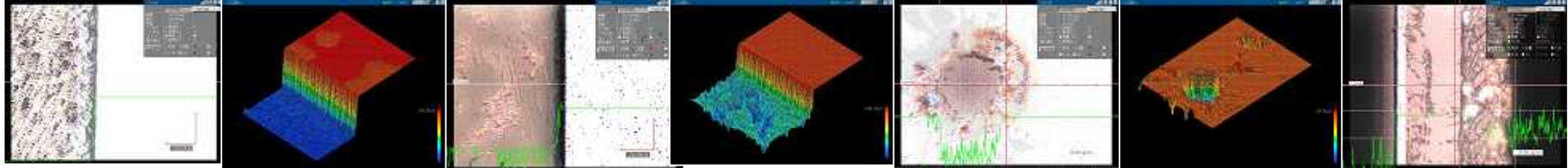
複合材(ガラス + Si)

複合材(プラスチック + LED)

GaAsフルカット(断面)/金電極(裏面)

アルミナ複合材(断面)

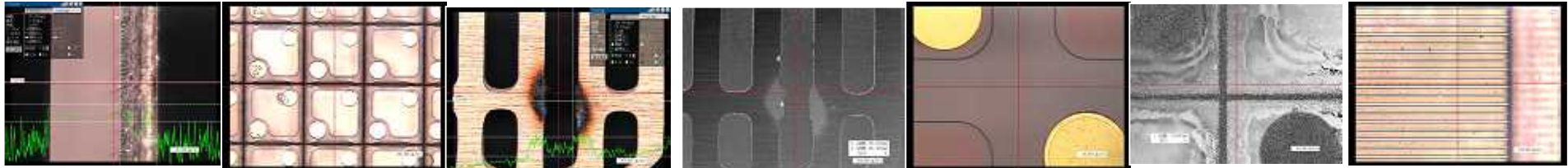
微細畏敬穴あけ



複合材(Si及びガラス)食違い切断

ガラス基盤上Siのみへの穴あけ

サファイアスクライブ断面



GaAsスクライブ

タイバーカット

サファイア表面/裏面(表面から裏面をカット)

ITO上ガラス切除(右部)



積層金属微細溶接

硬質セラミックチップフルカット切断

ホウ珪酸ガラススクライブ

テンバックスフルカット断面



Si上微細電極貫通孔作成

サファイアフルカット断面

Si+ガラス高速フルカット断面

GaPフルカット断面、表面、裏面電極



400 μmサファイアスクライブ&フルカット

マイクロクリーニング(前後)

400 μmSi貫通孔

透明サファイアダイシング